

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-09

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日）
参与单位名称	通过全景网投资者关系互动平台参与“2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的广大投资者
时间	2023 年 11 月 15 日（周三）下午 14:00~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长/总经理：许文焕，副总经理/董事会秘书：高健，财务总监：范长征，证券事务代表：陈国兵，杨佳睿
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司参加由深圳证监局指导，深圳上市公司协会举办的举办“沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持续发展”2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与广大投资者通过网络平台进行实时文字沟通。主要问题和回复内容整理如下：</p> <p>1、请问，公司未来盈利情况？</p> <p>答：您好，感谢您的提问！公司业务主要包含条码识别和半导体业务两大块。</p> <p>条码识别业务是公司的传统主业，自上市以来一直保持较高的毛利率和良好的经营净现金流。未来条码识别业务将一直作为公司的基础业务之一，为公司发展提供稳定的经营现金流。</p> <p>半导体业务，公司目前已完成功率半导体产业 smart IDM 生态圈核心环节的布局，主要包括功率半导体设计、原材料硅片、晶圆代工、超薄片背道减薄等，未来三到五年，产业链每一个环节都会保持持续扩产的状态，公司也将进入高速成长通道。</p> <p>2、请问公司布局半导体赛道各公司现在协同发展效果如何？</p> <p>答：您好，感谢您的提问！公司近年致力于打造功率半导体 smart IDM 生态圈，目前已完成了晶圆制造（广芯微电子）、超薄片背道加工（芯微泰克）、外延片制造（晶睿电子）、芯片设计（广微集成、丽隼半导体）等关键环节的布局。各环节企业已展开</p>

具体业务合作，在原材料供应、产线建设及调试等方面均有密切配合，广微集成在 2021 年已完成对晶睿电子硅外延片全系列产品的测试验证，并批量采购；广微集成、丽隽半导体以及广芯微电子目前正密切配合，对晶圆产线进行调试。后续随着晶圆代工、背道代工企业等环节的量产及持续扩产，以及 smart IDM 生态圈的不断扩展，产业链协同效益将得到更充分体现。

3、公司半导体二期有探讨，什么时间有进展？公司半导体销售团队的建设及能力如何？

答：您好，感谢您的提问！广芯微电子项目一期规划硅基晶圆产能约为 10 万片/月（6 英寸），项目目前正处在设备调试及批量试产阶段。二期项目将根据公司发展和市场情况来推进。

公司已有稳定的销售团队，并在不断扩充，未来随着广芯微产能的释放和产品类型的增加，也将充分利用上市公司已有资源和渠道去拓宽市场。

4、您怎么看待公司未来半导体产业发展？何时对公司能产生业绩？

答：您好，感谢您的提问！公司目前已完成功率半导体产业 smart IDM 生态圈核心环节的布局，主要包括功率半导体设计、原材料硅片、晶圆代工、超薄片背道减薄等，未来三到五年，产业链每一个环节都会保持持续扩产的状态，公司也将进入高速成长通道。

5、谢刚博士在半导体方面公司给了科学家级别的评价，但从 5 月中旬到现在一直在做着二级管的调试，0 到 1 还进展缓慢。他的半导体长处在哪？这总产出和产品广微集成的销售何以保证？

答：您好，感谢您的提问！以谢刚博士为首的广芯微核心技术团队，长期从事硅基功率半导体及宽禁带功率半导体器件的研发及产业化工作，具备丰富的理论及生产实践经验。

广芯微电子项目于今年 5 月 19 日投产通线，项目整体按照计划推进中。参照晶圆制造流程，产品批量生产需经历工程批-验证批-风险批等环节，同时伴随着设备稳定、良率提升等过程，客观上需要一定时间来完成。广芯微电子作为一家新建的晶圆代工厂，在从 0 到 1 的过程中会遇到很多难以预计的困难和问题，目前在进行设备调试及批量试产工作，后续产品从 1 到 10 的扩张进度将会更快，明年广芯微电子也将根据市场情况逐步提升产能，并推出更多的新产品。

	<p>6、半年多了，6寸的和12寸的出片量多少？IGBT，碳化硅的新品研发进展？</p> <p>答：您好，感谢您的提问！广芯微电子项目一期规划硅基晶圆产能约为10万片/月（6英寸），目前正处在设备调试及批量试产阶段。广芯微电子目前正全力保障 MFER 和特高压 MOS 的量产工作，IGBT、碳化硅等产品将会和设计公司一起做好前期准备工作，具体进度将根据项目调试进度和市场情况来推进。后续如有相应进展，我们将严格按照深交所等要求，及时披露相关信息。</p> <p>7、公司已向半导体产业投入近十几亿。现在我们主业扫码十半导体的市值才40多亿，您作为董秘觉得市场真实反应了公司的基本面了吗？</p> <p>答：您好，感谢您的提问！公司始终坚持以每股价值最大化为长期经营目标，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。未来，公司将继续加强经营管理，持续提升业绩和股东回报水平，并积极做好投资者交流工作，以充分反应公司的价值。</p> <p>8、公司广芯微通线半年多，现在月产能达到多少？广微集成都在等广芯微的产品，如何规划。总不见起色</p> <p>答：您好，感谢您的提问！广芯微电子项目于今年5月19日投产通线，目前正处在设备调试及批量试产阶段。后续广芯微电子将根据市场情况逐步提升产能，并推出更多的新产品。如有相应进展，我们将严格按照深交所等要求，及时披露相关信息。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023-11-15